



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaruan Semiconductor Co., Ltd.

制图 赖谊成

审阅 罗云龙

核准 林钟涛

DIP-8

文件名称:

HG-DIP8

文件编号:

HGMXT-230004

版本 V1.0

比例 1:1

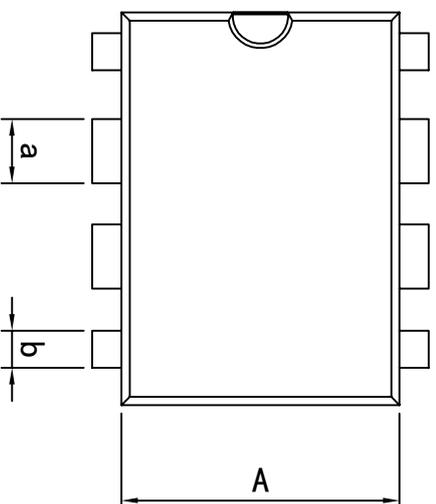
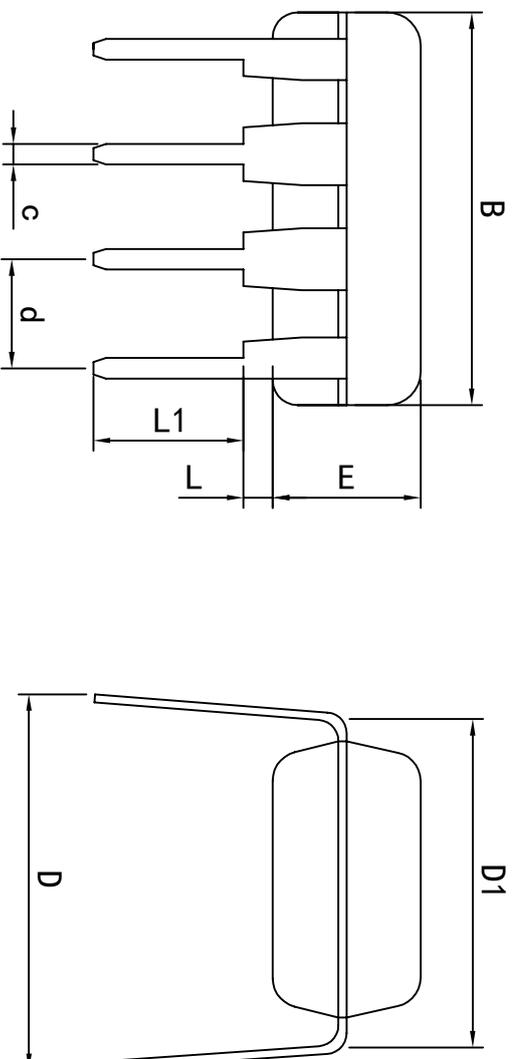
单位 mm

日期 2023-6-26

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT: mm

DIM.	A	B	D	D1	E	L	L1	a	b	C	d
MIN	6.10	9.00	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54
MAX	6.68	9.50	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	BSC